

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-046

生益电子股份有限公司

关于全资子公司投资建设“芯算智联”高速互联电路板 制造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**“芯算智联”高速互联电路板制造项目
- **投资金额：**计划投资总额约为 225,700.00 万元，其中包括已投入的厂房建设费用，本次新增投资约 215,800.00 万元。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

该事项已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议和第四届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交股东会审议。本次投资事项尚须政府主管部门备案及环评、能评等审批，后续公司将根据项目进度及实际情况，按照法律法规和政策规定办理项目实施所需的其他相关程序或手续。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、本项目投资总额较高，且资金来源为自有及自筹资金，因此本项目的资金保障可能会受到公司经营情况的影响。若资金筹措不及预期，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时，项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

2、本项目实施尚需政府备案及环评、能评等审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务推广进度、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存

在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但国际经济环境复杂多变，行业政策、市场和技术变化以及内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及投资收益不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为抢抓行业发展机遇，满足市场 HDI 产品快速增长的需求，进一步深化产能布局和升级产品结构，公司计划由全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）在现有厂房投资建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目。计划投资总额约为 225,700.00 万元，其中包括已投入的厂房建设费用，本次新增投资约 215,800.00 万元（因厂房为已有厂房，以下交易要素按此金额统计）。该项目建成后，将扩大公司 HDI 产品产能和公司经营规模，进一步提升公司盈利水平和行业竞争力。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	“芯算智联”高速互联电路板制造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：约为 <u>215,800.00 万元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金

	☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资“芯算智联”高速互联电路板制造项目的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。本次投资事项尚须政府主管部门备案及环评、能评等审批，后续公司将根据项目进度及实际情况，按照法律法规和政策规定办理项目实施所需的其
他相关程序或手续。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司计划由全资子公司吉安生益在现有厂房部分楼层投资建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目，计划投资总额约为 225,700.00 万元，其中包括已投入的厂房建设费用，本次新增投资约 215,800.00 万元。产品定位应用于 AI 服务器、汽车电子等相关领域的 HDI 印制线路板，项目将分阶段建设，全部建成后设计产能 44.59 万平方米/年。

（二）投资标的的信息

（1）项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	“芯算智联”高速互联电路板制造项目
项目主要内容	应用于 AI 服务器、汽车电子等相关领域的 HDI 印制线路板

建设地点	江西省吉安市井冈山经济技术开发区
项目总投资金额（万元）	约为 225,700.00 万元，其中包括已投入的厂房建设费用，本次新增投资约 215,800.00 万元
上市公司投资金额（万元）	约为 225,700.00 万元，其中包括已投入的厂房建设费用，本次新增投资约 215,800.00 万元
项目建设期（月）	36
预计开工时间	2026/09/28
预计投资收益率	15%（税后）
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2）各主要投资方出资情况

本投资项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，项目实施主体为公司全资子公司吉安生益，拟以自有资金及自筹资金建设投资项目。

（3）项目目前进展情况

本项目目前处于前期筹备阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

随着 AI 大模型的商业化落地，算力需求呈指数级增长，并推动高密度（HDI）PCB 产品需求增长。根据 Prismark 报告，预计 2025-2030 年 HDI PCB 产品复合年增长率为 13.1%，在 2030 年 HDI 产品的产值将达到约 300.1 亿美元，约占 PCB 市场的 20.8%，是 PCB 中最具潜力的增长板块之一。为抢抓市场机遇，进一步优化产能结构、提升高价值订单承接能力，公司计划通过吉安生益投资建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目，该项目将承接应用于 AI 服务器、汽车电子等相关领域的 HDI 批量产品，为公司承接 4 阶以上高端 HDI 产品释放更多产能空间。

本项目是公司抢抓行业发展机遇，为满足市场 HDI 产品快速增长的需求，进一步深化产能布局、升级产品结构所实施的投资行为，符合国家相关的产业政策和行业发展趋势，有利于公司进一步扩大中高端产品产能和公司经营规模，促进公司产业化发展，从而提升公司盈利能力和行业竞争力。

（三）出资方式及相关情况

该项目资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目契合市场发展需求，符合公司整体经营发展战略规划，有利于进一步优化公司产能结构和产品布局，将有效提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司

具有积极的战略意义。本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本项目投资总额较高，且资金来源为公司自有及自筹资金，因此本项目的资金保障可能会受到公司经营情况的影响。公司近年来现金流稳定，公司将统筹资金安排，以确保项目顺利实施。

2、本项目实施尚需政府备案及环评、能评等审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为项目实施提供多方面的支持，全力配合各项审批工作的推进。

3、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务推广进度、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低市场风险。

4、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但国际经济环境复杂多变，行业政策、市场和技术变化以及内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及投资收益不达预期的风险。公司将保持对宏观环境、政策等外部因素的高度关注，持续夯实技术创新、质量管理水平，进一步强化人力资源管理和供应链管理保障项目实施，以降低内外部不确定因素带来负面影响的风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年8月29日